

中国生物材料学会

中生材学会〔2026〕22号

中国生物材料学会关于 第二十八届中国科协年会—— 医用生物电子材料专题论坛征稿的通知

为深入贯彻党的二十届四中全会精神，锚定高水平科技自立自强战略目标，发挥科协组织独特优势，中国科协组织全国学会联合国家战略科技力量，围绕“抢占制高点 催生新动能 为中国式现代化提供科技支撑”的主题，组织开展第二十八届中国科协年会系列学术活动。其中，中国生物材料学会将于2026年7月25-26日承办“第二十八届中国科协年会—医用生物电子材料”专题论坛。现正式启动本次论坛征稿工作，诚邀相关领域专家学者、工程技术人员、高校师生及各有关单位踊跃投稿、

积极参与学术交流与研讨。现将征文相关事宜通知如下：

一、征稿说明

（一）征稿方向

征稿方向包括但不限于：面向脑机接口的先进功能材料与电极技术、生物电子界面的创新设计、柔性/可拉伸电子器件、神经信号检测与调控的新原理及新方法，以及脑机接口算法、系统集成技术，及其在诊断、治疗与康复等领域的新技术、新工艺、新产品与新成果。

（二）征稿类型

本次征稿设会议摘要与会议论文两类，入选后可享受相应学术交流与成果推广权益：

1.会议摘要：入选后可参与本次论坛及墙报展示等系列交流活动；

2.会议论文：入选后除参与论坛交流外，将推荐参评中国科协年会百篇最具影响力学术论文，获重点宣传推广；同时论文将以专题形式在 *Regenerative Biomaterials* 期刊发表，所有入选论文统一标注“第二十八届中国科协年会学术论文成果”。

二、投稿要求

（一）论文要求紧扣本次大会主题，研究成果具有较高学术价值或理论水平；

（二）投稿文章须为原创未被其他刊物收录，且无一稿多投，引用他人著述注明出处，作者署名无争议，稿件内容无涉

密。

三、投稿方式

(一) 会议摘要

1. 投稿邮箱: Jndxliangll@163.com;

2. 邮件主题: “第二十八届科协年会+论文题目+作者单位+作者姓名”;

3. 摘要须以 Word 格式编排, 模板详见附件;

4. 摘要截止日期: 2026 年 5 月 10 日。

(二) 会议论文

1. 投稿渠道: 请登录 *Regenerative Biomaterials* 官方投稿网站 (<https://mc.manuscriptcentral.com/rb>), 查阅详细投稿指南并完成在线投稿;

2. 投稿备注: 投稿时请务必注明“Special Forum on Medical Bioelectronic Materials, The 28th Annual Meeting of CAST”;

3. 论文截止日期: 2026 年 4 月 30 日。

四、联系人

(一) 会议摘要投稿

联系人: 梁老师

电话: 15801620961

邮箱: Jndxliangll@163.com

(二) 会议论文投稿

联系人: 刘潇钦

电话：028-85417078

邮箱：xsb@csbm.org.cn

附件：“医用生物电子材料专题论坛”会议摘要模版

